

High Voltage Power MOSFET

IXTU01N100
IXTY01N100

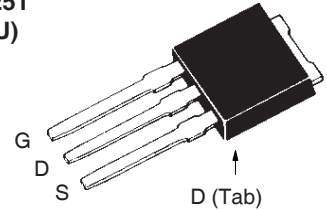
$V_{DSS} = 1000V$
 $I_{D25} = 100mA$
 $R_{DS(on)} \leq 80\Omega$

N-Channel Enhancement Mode

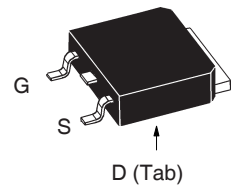


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	1000	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$, $R_{GS} = 1M\Omega$	1000	V
V_{GSS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ C$	100	mA
I_{DM}	$T_C = 25^\circ C$, Pulse Width Limited by T_{JM}	400	mA
P_D	$T_C = 25^\circ C$	25	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ C$
T_{JM}		150	$^\circ C$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ C$
T_L	Maximum Lead Temperature for Soldering	300	$^\circ C$
T_{SOLD}	1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s	260	$^\circ C$
F_C	Mounting force	1.13 / 10	Nm/lb.in.
Weight	TO-251	0.40	g
	TO-252	0.35	g

TO-251
(IXTU)



TO-252
(IXTY)



G = Gate D = Drain
S = Source Tab = Drain

Features

- International Standard Packages
- Fast Switching Times
- Avalanche Rated
- $R_{ds(on)}$ HDMOS™ Process
- Rugged Polysilicon Gate Cell structure

Advantages

- High Power Density
- Space Savings

Applications

- Level Shifting
- Triggers
- Solid State Relays
- Current Regulators

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ C$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0V$, $I_D = 25\mu A$	1000		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 25\mu A$	2.0		4.5 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V$, $V_{DS} = 0V$			± 50 nA
I_{DSS}	$V_{DS} = 0.8 \cdot V_{DSS}$, $V_{GS} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			10 μA 200 μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V$, $I_D = 50mA$, Note 1		60	80 Ω

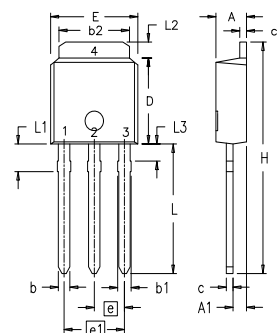
Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 50\text{mA}$, Note 1		0.16	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{V}$, $V_{DS} = 25\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$		54.0	pF
C_{oss}			6.9	pF
C_{rss}			2.0	pF
$t_{d(on)}$	Resistive Switching Times $V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 50\text{mA}$ $R_G = 50\Omega$ (External)		12	ns
t_r			12	ns
$t_{d(off)}$			40	ns
t_f			28	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{V}$, $V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}$, $I_D = 50\text{mA}$		6.9	nC
Q_{gs}			1.8	nC
Q_{gd}			3.0	nC
R_{thJC}			5	$^\circ\text{C/W}$

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{V}$			100 mA
I_{SM}	Repetitive, Pulse Width Limited by T_{JM}			300 mA
V_{SD}	$I_F = I_S$, $V_{GS} = 0\text{V}$, Note 1			1.8 V
t_{rr}	$I_F = 0.75\text{A}$, $-di/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$, $V_R = 25\text{V}$			1.5 μs

Note 1: Pulse test, $t \leq 300\mu\text{s}$, duty cycle, $d \leq 2\%$.

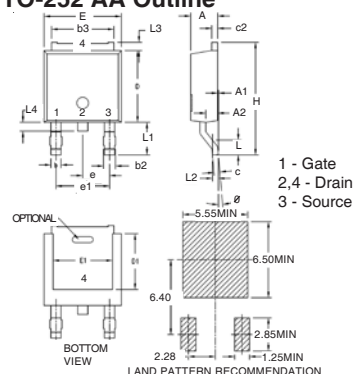
TO-251 Outline



1. Gate 2. Drain
3. Source 4. Drain

Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.19	2.38	.086	.094
A1	0.89	1.14	0.35	.045
b	0.64	0.89	.025	.035
b1	0.76	1.14	.030	.045
b2	5.21	5.46	.205	.215
c	0.46	0.58	.018	.023
c1	0.46	0.58	.018	.023
D	5.97	6.22	.235	.245
E	6.35	6.73	.250	.265
e	2.28	BSC	.090	BSC
e1	4.57	BSC	.180	BSC
H	17.02	17.78	.670	.700
L	9.89	9.65	.350	.380
L1	1.91	2.28	.075	.090
L2	0.89	1.27	.035	.050

TO-252 AA Outline



- 1 - Gate
2, 4 - Drain
3 - Source

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.086	.094	2.19	2.38
A1	0	.005	0	0.12
A2	.038	.046	0.97	1.17
b	.025	.035	0.64	0.89
b2	.030	.045	0.76	1.14
b3	.200	.215	5.08	5.46
c	.018	.024	0.46	0.61
c2	.018	.023	0.46	0.58
D	.235	.245	5.97	6.22
D1	.180	.205	4.57	5.21
E	.250	.265	6.35	6.73
E1	.170	.205	4.32	5.21
e	.090 BSC		2.28 BSC	
e1	.180 BSC		4.57 BSC	
H	.370	.410	9.40	10.42
L	.055	.070	1.40	1.78
L1	.100	.115	2.54	2.92
L2	.020 BSC		0.50 BSC	
L3	.025	.040	0.64	1.02
L4	.025	.040	0.64	1.02
θ	0°	10°	0°	10°

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,860,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

Fig. 1. Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

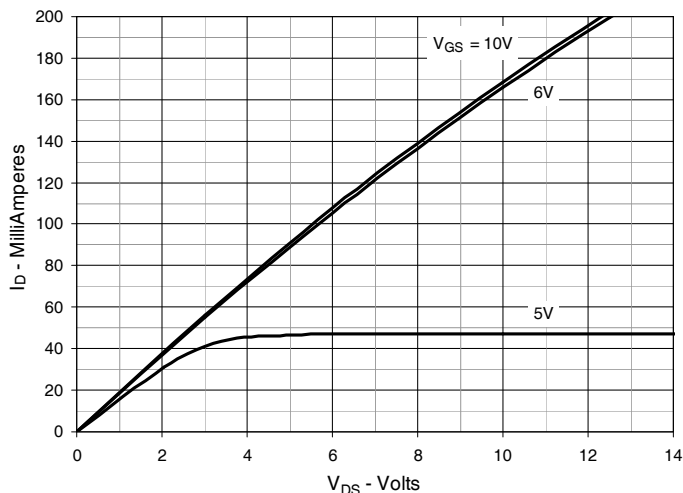


Fig. 2. Extended Output Characteristics @ $T_J = 25^\circ\text{C}$

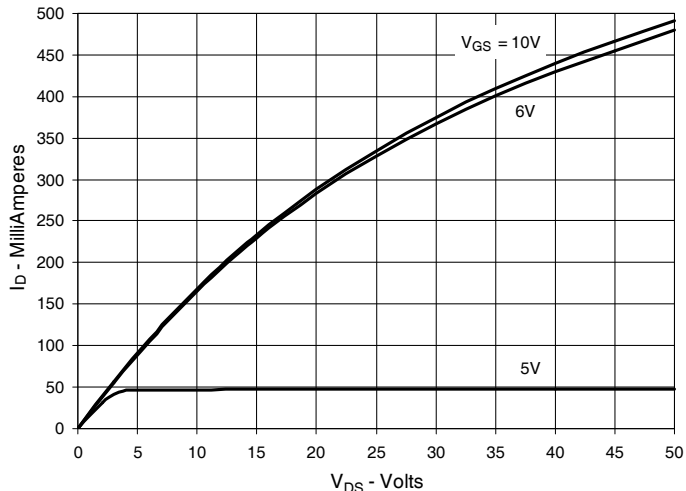


Fig. 2. Output Characteristics @ $T_J = 125^\circ\text{C}$

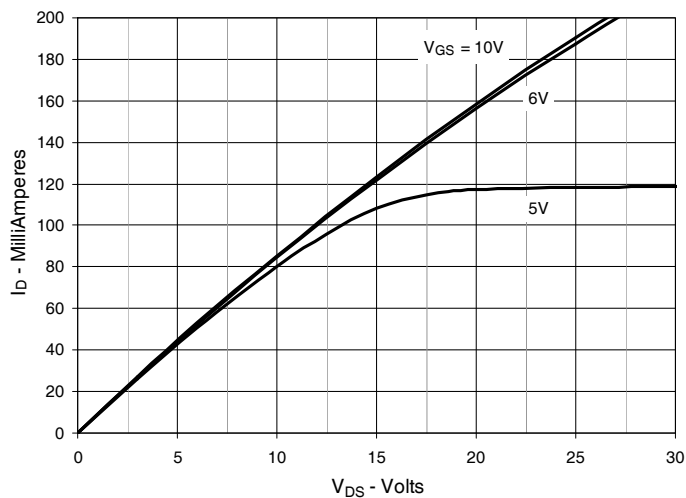


Fig. 3. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 50\text{mA}$ Value vs. Junction Temperature

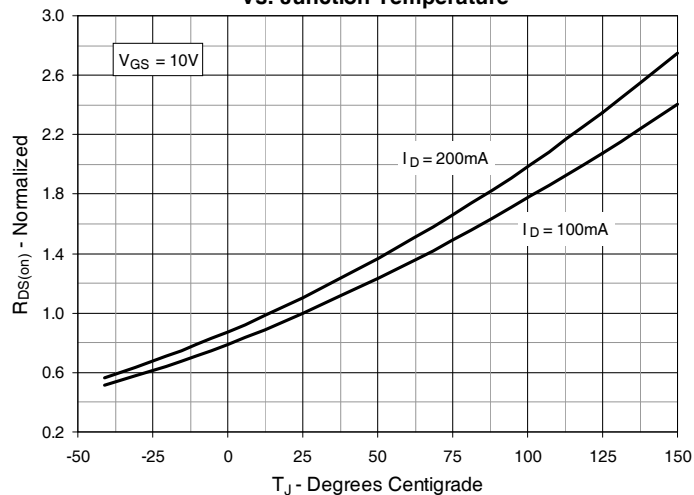


Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 50\text{mA}$ Value vs. Drain Current

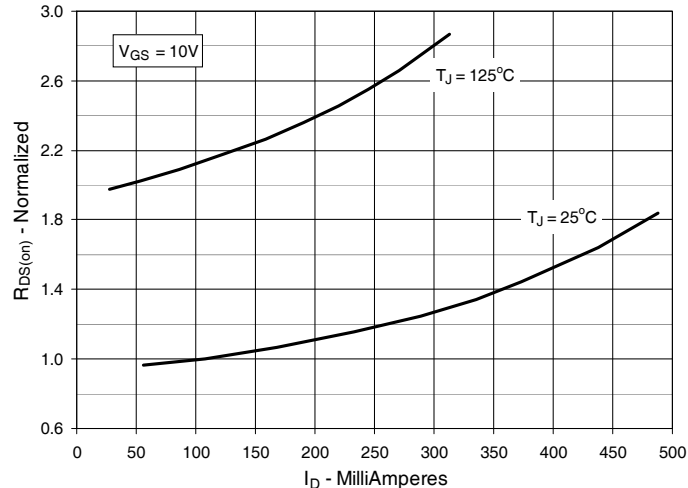


Fig. 5. Maximum Drain Current vs. Case Temperature

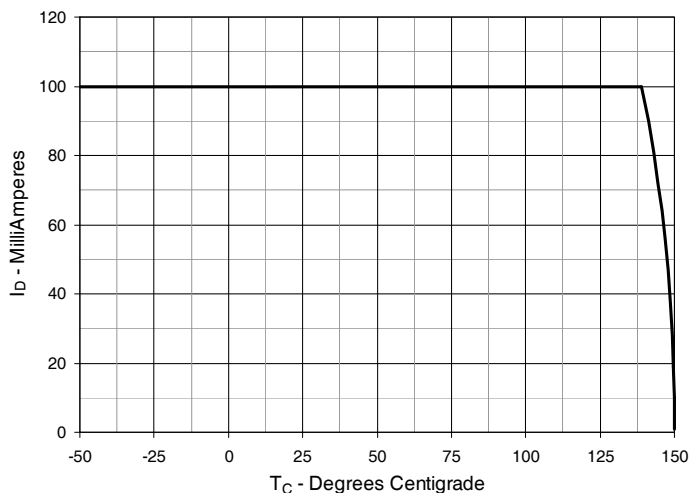


Fig. 7. Input Admittance

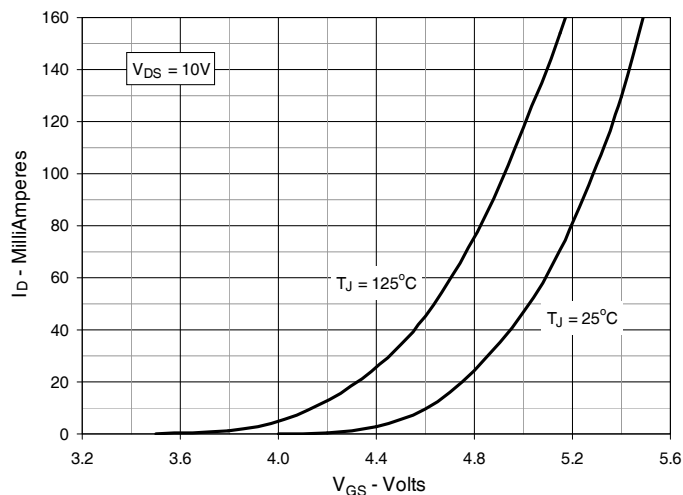


Fig. 8. Transconductance

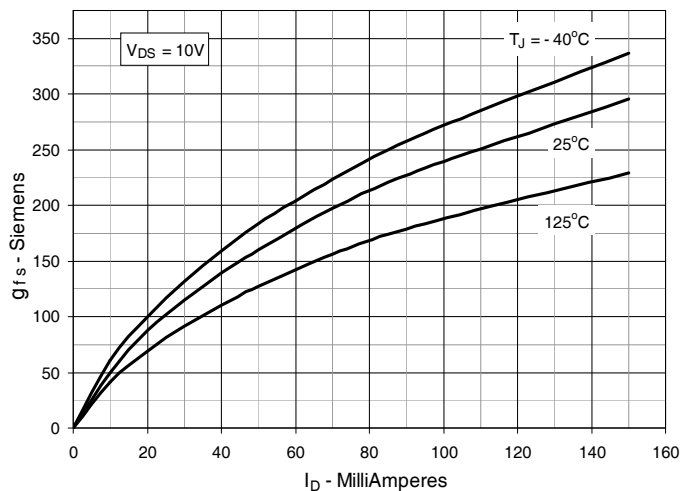


Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

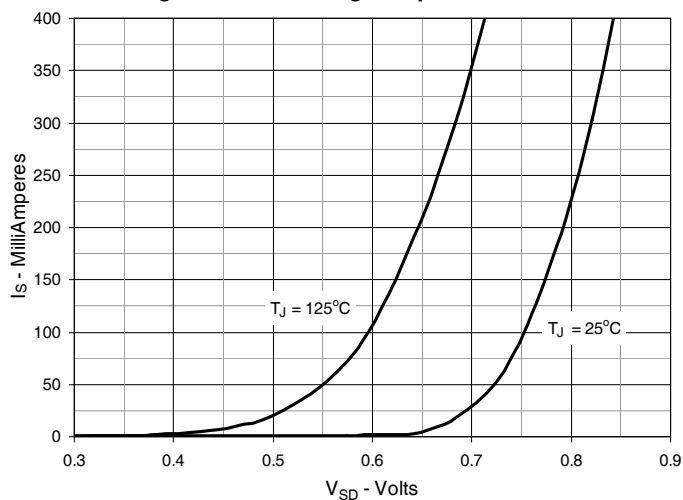


Fig. 10. Gate Charge

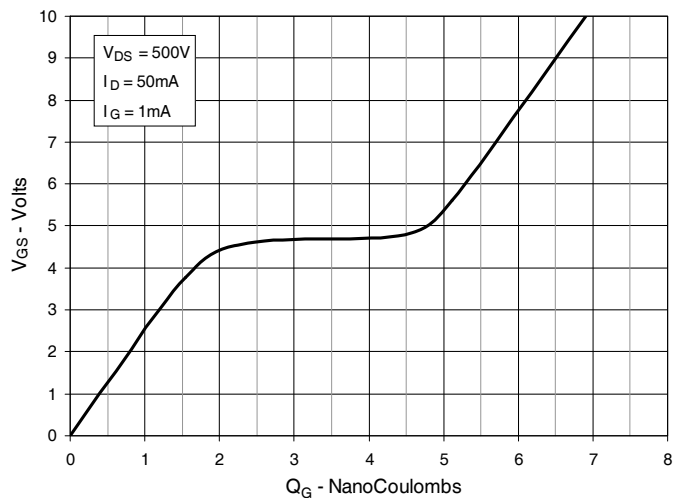


Fig. 11. Capacitance

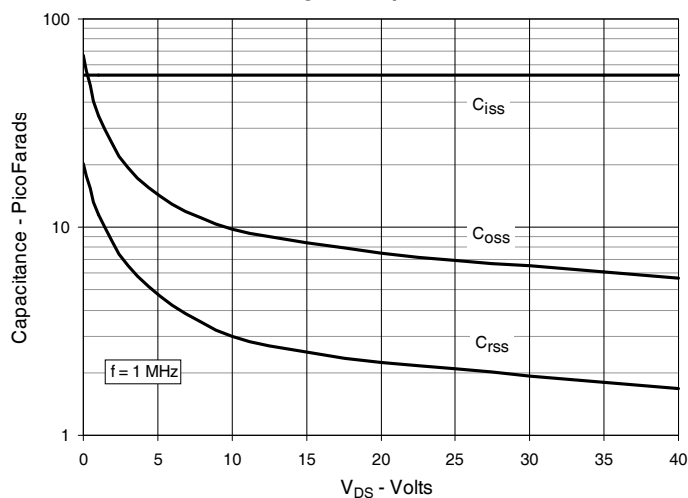
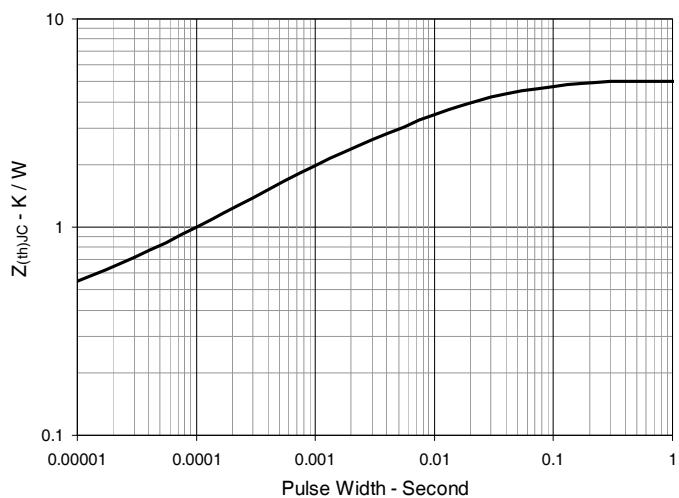


Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance





Disclaimer Notice - Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru